

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT										
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT										
CONVEYING PARTY DATA											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Execution Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cascade Microtech Dresden GmbH</td> <td>10/01/2010</td> </tr> </tbody> </table>		Name	Execution Date	Cascade Microtech Dresden GmbH	10/01/2010						
Name	Execution Date										
Cascade Microtech Dresden GmbH	10/01/2010										
RECEIVING PARTY DATA											
<table border="1"> <tr> <td>Name:</td> <td>Cascade Microtech, Inc.</td> </tr> <tr> <td>Street Address:</td> <td>9100 SW Gemini Drive</td> </tr> <tr> <td>City:</td> <td>Beaverton</td> </tr> <tr> <td>State/Country:</td> <td>OREGON</td> </tr> <tr> <td>Postal Code:</td> <td>97008</td> </tr> </table>		Name:	Cascade Microtech, Inc.	Street Address:	9100 SW Gemini Drive	City:	Beaverton	State/Country:	OREGON	Postal Code:	97008
Name:	Cascade Microtech, Inc.										
Street Address:	9100 SW Gemini Drive										
City:	Beaverton										
State/Country:	OREGON										
Postal Code:	97008										
PROPERTY NUMBERS Total: 1											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Property Type</th> <th>Number</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Application Number:</td> <td>13640432</td> </tr> </tbody> </table>		Property Type	Number	Application Number:	13640432						
Property Type	Number										
Application Number:	13640432										
CORRESPONDENCE DATA											
<p>Fax Number: 5032247329 <i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i></p> <p>Phone: 503-224-7529 Email: shilpa@dascenzoiplaw.com Correspondent Name: CASCADE MICROTECH, INC Address Line 1: c/o Dascenzo Intellectual Property Law, Address Line 2: 522 SW 5th Avenue, Suite 925 Address Line 4: Portland, OREGON 97204</p>											
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	CMI 3M3US										
NAME OF SUBMITTER:	David S. D'Ascenzo										
<p>Total Attachments: 10 source=Assignment_Cover_Sheet_with_Assignment_CMI3M3US_10-10-12#page1.tif source=Assignment_Cover_Sheet_with_Assignment_CMI3M3US_10-10-12#page2.tif source=Assignment_Cover_Sheet_with_Assignment_CMI3M3US_10-10-12#page3.tif source=Assignment_Cover_Sheet_with_Assignment_CMI3M3US_10-10-12#page4.tif</p>											

CH \$40.00 13640432

source=Assignment_Cover_Sheet_with_Assignment_CMI3M3US_10-10-12#page5.tif
source=Assignment_Cover_Sheet_with_Assignment_CMI3M3US_10-10-12#page6.tif
source=Assignment_Cover_Sheet_with_Assignment_CMI3M3US_10-10-12#page7.tif
source=Assignment_Cover_Sheet_with_Assignment_CMI3M3US_10-10-12#page8.tif
source=Assignment_Cover_Sheet_with_Assignment_CMI3M3US_10-10-12#page9.tif
source=Assignment_Cover_Sheet_with_Assignment_CMI3M3US_10-10-12#page10.tif


RECORDATION FORM COVER SHEET PATENTS ONLY

To the Director of the U.S. Patent and Trademark Office: Please record the attached documents or the new address(es) below.

1. Name of conveying party(ies) CASCADE MICROTECH DRESDEN GmbH Additional name(s) of conveying party(ies) attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	2. Name and address of receiving party(ies) Name: <u>CASCADE MICROTECH, INC.</u> Internal Address: _____ _____ Street Address: <u>9100 SW GEMINI DRIVE</u> _____ City: <u>BEAVERTON</u> State: <u>OREGON</u> Country: <u>USA</u> Zip: <u>97008</u> Additional name(s) & address(es) attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
3. Nature of conveyance/Execution Date(s): Execution Date(s) <u>10/1/2010</u> <input checked="" type="checkbox"/> Assignment <input type="checkbox"/> Merger <input type="checkbox"/> Security Agreement <input type="checkbox"/> Change of Name <input type="checkbox"/> Joint Research Agreement <input type="checkbox"/> Government Interest Assignment <input type="checkbox"/> Executive Order 9424, Confirmatory License <input type="checkbox"/> Other _____	

4. Application or patent number(s): A. Patent Application No.(s) Additional numbers attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> This document is being filed together with a new application. B. Patent No.(s) Additional numbers attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Name and address to whom correspondence concerning document should be mailed: Name: <u>DAVID S. D'ASCENZO</u> Internal Address: <u>DASCENZO Intellectual Property</u> <u>Law, P.C.</u> Street Address: <u>522 SW 5TH AVENUE, SUITE 925</u> _____ City: <u>PORTLAND</u> State: <u>OREGON</u> Zip: <u>97204</u> Phone Number: <u>(503) 224-7529</u> Fax Number: <u>(503) 224-7329</u> Email Address: <u>david@dascenzoiplaw.com</u>	6. Total number of applications and patents involved: <u>1</u> 7. Total fee (37 CFR 1.21(h) & 3.41) \$ <u>40.00</u> <input checked="" type="checkbox"/> Authorized to be charged to deposit account <input type="checkbox"/> Enclosed <input type="checkbox"/> None required (government interest not affecting title) 8. Payment Information Deposit Account Number <u>50-4551</u> Authorized User Name <u>DAVID S. D'ASCENZO</u>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Signature:  _____ Signature David S. D'Ascenzo Name of Person Signing	October 10, 2012 Date Total number of pages including cover sheet, attachments, and documents: 10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documents to be recorded (including cover sheet) should be faxed to (571) 273-0140, or mailed to:
Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the USPTO, P.O.Box 1450, Alexandria, V.A. 22313-1450

APPENDIX B

PATENT AND PATENT APPLICATION ASSIGNMENT

THIS PATENT AND PATENT APPLICATION ASSIGNMENT is made as of October 1, 2010, by Cascade Microtech Dresden GmbH, a German limited liability company registered with Dresden local court under HRB3021, having a principal place of business at Suss-Strasse 1, 01561 Sacka, Germany, hereinafter referred to as the ASSIGNOR, to Cascade Microtech, Inc., an Oregon corporation, having a principal place of business at 2430 NW 206th Avenue, Beaverton, Oregon 97006 USA, hereinafter referred to as the ASSIGNEE.

ASSIGNOR is the owner of the entire and undivided right, title, and interest in certain inventions, patents and patent applications identified on Schedule "A" attached hereto (the "ASSIGNED PATENTS AND PATENT APPLICATIONS").

ASSIGNEE desires to acquire the entire right, title and interest of ASSIGNOR in and to said ASSIGNED PATENTS AND PATENT APPLICATIONS.

For good and valuable consideration paid by the ASSIGNEE, the receipt of which is hereby acknowledged, ASSIGNOR does hereby sell, assign and transfer to the ASSIGNEE, and ASSIGNEE hereby purchases, accepts and assumes, at ASSIGNEE's sole expense, ASSIGNOR's entire right, title and interest in and to the inventions described in the ASSIGNED PATENTS AND PATENT APPLICATIONS together with the ASSIGNED PATENTS AND PATENT APPLICATIONS, in the U.S. and every country foreign to the U.S., and all patent rights, including extensions or derivations thereof, both foreign and domestic, including any divisional, continuing including continuing-in-part (CIP), non-provisional and reissue patents that may issue on the ASSIGNED PATENTS AND PATENT APPLICATIONS, and further covenants that ASSIGNOR has full right so to do. ASSIGNEE hereby authorizes and requests the Commissioner of Patents that all U.S. patents that issue on the ASSIGNED PATENTS AND PATENT APPLICATIONS shall issue to ASSIGNEE. This assignment includes assignment to ASSIGNEE of the right to make application in its own behalf for protection of the ASSIGNED PATENTS AND PATENT APPLICATIONS and any patents issued on the ASSIGNED PATENTS AND PATENT APPLICATIONS, in the U.S. and countries foreign to the U.S., and to claim under the Patent Cooperation Treaty, the International Convention for the Protection of Industrial Property ('Paris Convention') and/or other international arrangement for any such application the date of any earlier U.S. application (or any other application on the invention) to gain priority with respect to other applications. The ASSIGNED PATENTS AND PATENT APPLICATIONS and all patents that issue on the ASSIGNED PATENTS AND PATENT APPLICATIONS shall be held and enjoyed by the ASSIGNEE, its successors and assigns as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by the ASSIGNOR had this assignment not been made, and shall include the right to seek redress for any act of infringement of the patent rights and/or provisional rights in the ASSIGNED PATENTS AND PATENT APPLICATIONS arising prior to the execution of this PATENT AND PATENT APPLICATION ASSIGNMENT.

ASSIGNOR covenants and agrees to execute such further and confirmatory assignments in recordable form as the ASSIGNEE may require to vest record title of said respective

ASSIGNED PATENTS AND PATENT APPLICATIONS in ASSIGNEE. Assignor further agrees to communicate to Assignee, or its successors and assigns, any facts, and to provide any documents known to Assignor respecting said invention, to testify in any legal proceeding, to sign all lawful papers, to execute all divisional, continuing including continuing-in-part (CIP), non-provisional and reissue applications, to make all rightful oaths, and to do everything reasonably necessary to aid Assignee, its successors and assigns to obtain and enforce proper patent protection for said ASSIGNED PATENTS AND PATENT APPLICATIONS in this or any foreign country.


IN WITNESS WHEREOF, the ASSIGNOR has caused this Assignment to be executed by a duly authorized officer.

Cascade Microtech Dresden GmbH

By: _____

Name: Dr. Claus Dietrich
Title: Managing Director

Cascade Microtech, Inc.

By:  _____
Name: Steve Harris
Title: Executive VP

ASSIGNED PATENTS AND PATENT APPLICATIONS in ASSIGNEE. Assignor further agrees to communicate to Assignee, or its successors and assigns, any facts, and to provide any documents known to Assignor respecting said invention, to testify in any legal proceeding, to sign all lawful papers, to execute all divisional, continuing including continuing-in-part (CIP), non-provisional and reissue applications, to make all rightful oaths, and to do everything reasonably necessary to aid Assignee, its successors and assigns to obtain and enforce proper patent protection for said ASSIGNED PATENTS AND PATENT APPLICATIONS in this or any foreign country.

IN WITNESS WHEREOF, the ASSIGNOR has caused this Assignment to be executed by a duly authorized officer.

Cascade Microtech Dresden GmbH

By:  *Cla. Dietrich*

Cascade Microtech Dresden GmbH
Süßs-Straße 1
01561 Thendorf OT Sacka
Germany *22.12.1990*

Name: Dr. Claus Dietrich
Title: Managing Director

Cascade Microtech, Inc.

By: _____
Name: Steve Harris
Title: Executive VP

PATENT ASSIGNMENT SCHEDULE "A"

PATENTS AND PATENT APPLICATIONS

Unser Zeichen	VgArt	SSt Bez	Lnd	Name	Amt-Az -1-	Amt-Az -2-	Titel
D7400079JP	PT	angemeldet (filed)	JP	Cascade Microtech Dresden GmbH	2004-094038	2004-310839	Calibration method for carrying out multiport measurements on semiconductor wafers
D7400267JP	PT	angemeldet	JP	Cascade Microtech Dresden GmbH	2004-249234	2005-101584	Apparatus for testing substrates
D7400315JP	PT	angemeldet	JP	Cascade Microtech Dresden GmbH	2004-249235	2005-093998	Arrangement and method for testing substrates under load
D7600299JP	PT	angemeldet	JP	Cascade Microtech Dresden GmbH	2006-246208	2007-086065	Process for the inspection of a variety of repetitive structures
D7700020US	PT	erteilt (granted)	US	Cascade Microtech Dresden GmbH	11/942,091	US-2008-0125999-A1	Method for Calibration of a vectorial network analyzer
D7700107JP	PT	angemeldet	JP	Cascade Microtech Dresden GmbH	2007-097538	2007-279039	Verfahren zur Messung der Impedanz elektronischer Schaltungen
D7700328US	PT	erteilt	US	Cascade Microtech Dresden GmbH	12/145,090	US-2009-0058442-A1	PROBER FOR TESTING COMPONENTS
D7700357JP	PT	angemeldet	JP	Cascade Microtech Dresden GmbH	2007-337423	2008-167447	Anordnung und Verfahren zur Bilderfassung an einem Prober
D7700360JP	PT	angemeldet	JP	Cascade Microtech Dresden GmbH	2007-297954	2008-131047	Probe Support und Verfahren zur Prüfung von Testsubstraten unter Verwendung des Probe Supports
D7700362JP	PT	angemeldet	JP	Cascade Microtech Dresden GmbH	2008-008004	2008-187172	Method for testing electronic components and test apparatus for carrying out the method
D7700363JP	PT	angemeldet	JP	Cascade Microtech Dresden GmbH	2007-297955	2008-131048	Prober zum Testen von Halbleitersubstraten mit EMI-Abschirmung
D7700366JP	PT	angemeldet	JP	Cascade Microtech Dresden GmbH	2008-117075	2008-272931	Vorrichtung und Verfahren zur Steuerung einer Bewegungseinrichtung
D7700367US	PT	angemeldet	US	Cascade Microtech Dresden GmbH	11/947,163	US-2008-0186602-A1	Device for rapidly changing objectives with the aid of threaded fastening
D7700369JP	PT	angemeldet	JP	Cascade Microtech Dresden GmbH	2007-337424	2008-166806	Anordnung und Verfahren zur fokussierten Mehrebenen-Bilderfassung an einem Prober
D7700376JP	PT	angemeldet	JP	Cascade Microtech Dresden GmbH	2008-007493	2009-025284	Method and arrangement for positioning a probe card
D7700391US	PT	erteilt	US	Cascade Microtech Dresden GmbH	11/942,095	US-2008-0122451-A1	Method for calibration of Vectorial Network Analyzer having more than two ports
D7700416DE	PT-PCT	angemeldet	DE	Cascade Microtech Dresden GmbH	PCT/EP2008/063154	WO 2009/050038	Verfahren zur Prüfung eines Testsubstrats unter definierten thermischen Bedingungen und thermisch konditionierbarer Prober
D7700416JP	PT-PCT	angemeldet	JP	Cascade Microtech Dresden GmbH	2010-528365		Verfahren zur Prüfung eines Testsubstrats unter definierten thermischen Bedingungen und thermisch konditionierbarer Prober
D7700417DE	PT-PCT	angemeldet	DE	Cascade Microtech Dresden GmbH	11 2008 002 564.9-35		Sondenhaltevorrichtung
D7700417JP	PT-PCT	angemeldet	JP	Cascade Microtech Dresden GmbH	2010-528422		Sondenhaltevorrichtung
D7900215WO	PT-PCT	angemeldet	WO	Cascade Microtech Dresden GmbH	PCT/EP2010/054829		Verfahren und Vorrichtung zur Kontaktierung einer Reihe von Kontaktflächen mit Sondenspitzen
D7900534DE	GM	eingetragen (valid for TM)	DE	Cascade Microtech Dresden GmbH	20 2010 003 817.0	20 2010 003 817.0	Prober für On-Wafer-Messungen unter EMI-Abschirmung
D8000019DE	PT	angemeldet	DE	Cascade Microtech Dresden GmbH	10 2010 006 607.9-52		Verfahren zur Inspektion von Strukturen von Halbleiterbauelementen
D8000165WO	PT-PCT	angemeldet	WO	Cascade Microtech Dresden GmbH	PCT/EP2010/058440		Verfahren zur Messung eines Leistungsbauelements
D8000188US	PT	angemeldet	US	Cascade Microtech Dresden GmbH	12/818,442		Probe Station for On-Wafer-Measurement under EMI-Shielding
D8000312DE	PT	angemeldet	DE	Cascade Microtech Dresden GmbH	10 2010 040 242.7		Modularer Prober und Verfahren zu dessen Betrieb

D66002DE	PT	erteilt	DE	Karl Suss GmbH	196 04 833.8-33	196 04 833.8	Anordnung zum Testen von Halbleiterstrukturen
D66110DE	PT	erteilt	DE	Karl Suss GmbH	196 38 816.3-33	DE 196 38 816 A1	Tester für Halbleiteranordnungen
D670004FR	PT- EPC	erteilt	FR	Karl Suss GmbH	97 91 72 20.2	0 880 706	Montage pour contrôle de structures à semiconducteur
D670004US	PT- PCT	erteilt	US	Karl Suss GmbH	09/142,391		ARRANGEMENT FOR THE TESTING OF SEMICONDUCTOR STRUCTURES
D690125DE	PT	erteilt	DE	Karl Suss GmbH	100 00 133.5-52	100 00 133.5	Prober für Drucksensoren
D710001EP	PT-EP	erteilt	EP	Karl Suss GmbH	01100251.6	1 114 988	Prober für Drucksensoren
D710002FR	PT-EP	angemeldet	FR	Karl Suss GmbH	01100251.6	1 114 988	Prober für Drucksensoren
D710002GB	PT-EP	erteilt	GB	Karl Suss GmbH	01100251.6	1 114 988	Prober für Drucksensoren
D710002IT	PT-EP	angemeldet	IT	Karl Suss GmbH	01100251.6	1 114 988	Prober für Drucksensoren
D710002US	PT	erteilt	US	Karl Suss GmbH	09/754,711	US-2002- 0152794-A1	PRESSURING SENSING PROBE
D7100199DE	PT	angemeldet	DE	Karl Suss GmbH	101 37 664.2-33	101 37 664.2	Halbleiterprüfvorrichtung
D7100271DE	GM	eingetragen	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	201 19 157.1	201 19 157.1	Vorrichtung zum Prüfen von Halbleiterscheiben
D710103DE	PT	erteilt	DE	Karl Suss GmbH	101 22 036.7-33	101 22 036.7	Substrathaltvorrichtung für Prober zum Testen von Schaltungsanordnungen auf scheibenförmigen Substraten
D710170DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	102 46 232.1-33	DE 102 46 232 A1	Prober mit Beladevorrichtung
D7200060US	PT	erteilt	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10/139,735	US-2002- 0163350-A1	SUBSTRATE-HOLDING DEVICE FOR TESTING CIRCUIT ARRANGEMENTS ON SUBSTRATES
D7200309DE	PT	erteilt	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	102 46 282.8-52	102 46 282.8- 52	Prober zum Testen von Substraten bei tiefen Temperaturen
D7300128DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	103 17 778.7-56		Verfahren zur Erhöhung der Genauigkeit der Positionierung eines ersten Objektes relativ zu einem zweiten Objekt
D7300315DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2004 022 679.2	10 2004 022 679 A1	Kanüle eines Probers für Differenzdrucksensoren
D7300316DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2005 015 335.6-52	DE 10 2005 015 335 A1	Druckprober zur partiellen, berührungslosen Druckmessung von Drucksensoren
D7300330US	PT	erteilt	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10/677,178	US 2004/0070415 A1	TEST APPARATUS FOR TESTING SUBSTRATES AT LOW TEMPERATURES
D7300332US	PT	erteilt	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10/677,524	US-2004- 0108847-A1	TEST APPARATUS WITH LOADING DEVICE
D7300346JP	PT	angemeldet	JP	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	2003-374619	2004-157121	Verfahren und Haltevorrichtung zum Testen von bewegungssensiblen Substraten
D7300347FR	PT	erteilt	FR	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	0312784		PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR TESTER DES SUBSTRATS SENSIBLES AUX MOUVEMENTS
D7300387DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	103 58 682.2-33	103 58 682 A1	Carrier zur Aufnahme von auf Trägersubstraten montierten Bauelementen
D7400078US	PT	erteilt	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10/810,417	US-2004- 0246004-A1	Calibration method for carrying out multiport measurements on semiconductor wafers
D7400107DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2004 012 740.9	DE 10 2004 012 740 A1	Anordnung zur Abtastung der Oberfläche oder physikalischer Reaktionssignale von Substraten
D7400118DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2004 013 707.2-33	DE1020040137 07A1	Vorrichtung zum Testen von Substraten
D7400136DE	GM	eingetragen	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	20 2004 005 165.6		Sondenhalterung an Probern für HF-Messung
D7400139DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2004 020 037.8-35	10 2004 020 037.8	Kalibrierverfahren zur Durchführung von Mehrformmessungen auf Halbleiterscheiben

D7400194DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2005 015 334.8-33	DE 10 2005 015 334 A1	Prober zum Testen von Substraten bei Temperaturen im Bereich der Siedetemperatur von Helium
D7400205US	PT	erteilt	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10/879,622	US-2005-0007135-A1	Method and prober for contacting a contact area with a contact tip
D7400236US	PT	erteilt	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	09/610,668		METHOD AND APPARATUS FOR SUB-MICRON IMAGING AND PROBING ON PROBE STATION
D7400239DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2004 030 881.0-35	10 2004 030 881	Verfahren und Prober zur Kontaktierung einer Kontaktfläche mit einer Kontaktspitze
D7400266US	PT	erteilt	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10/928,975	US-2005-0083036-A1	Apparatus for testing substrates
D7400291US	PT	erteilt	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	09/020,173		NON-CONTACT MEASUREMENT OF ELECTRICAL WAVEFORMS ON THE SURFACE OF A SAMPLE USING TIME DOMAIN GATING
D7400313DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2004 041 102.6-33	10 2004 041 102.6-33	Anordnung und Verfahren zum Testen von Substraten unter Belastung
D7400328DE	GM	eingetragen	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	20 2005 002 728.6	20 2005 002 728.6	Positionierungseinrichtung für den Chuck eines Probers
D7400390DE	PT	erteilt	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	103 07 561.5	DE 103 07 561 A1	Meßanordnung zur kombinierten Abtastung und Untersuchung von mikrotechnischen, elektrische Kontakte aufweisenden Bauelementen
D7500002DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2005 006 838.3-33	DE 10 2005 006 838 A1	Vorrichtung zum Testen von dünnen Elementen
D7500037DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2005 005 489.7	DE 10 2005 005 489 A1	Sondennadel und Verfahren zu deren Herstellung
D7500165DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2005 053 146.6-35	DE 10 2005 053 146 A1	Messspitze zur Hochfrequenzmessung
D7500211US	PT	erteilt	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	11/299,487	US-2007-0132465-A1	Probe station comprising a bellows with EMI shielding capabilities
D7500244DE	PT	erteilt	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2005 044 502.0-53	DE 10 2005 044 502 A1	Verfahren zur Inspektion einer Vielzahl sich wiederholender dreidimensionaler Strukturen
D7500384US	PT	erteilt	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	11/314,624	US-2007-0139067-A1	Device for Testing Thin Elements
D7500409DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2006 006 203.5-33	DE 10 2006 006 203 A1	Positionierungseinrichtung für den Chuck eines Probers
D7600118US	PT	erteilt	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	11/365,424	US-2006-0212248-A1	Procedure for reproduction a calibration position of an aligned and afterwards displaced calibration substrate in a probe station
D7600128US	PT	erteilt	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	11/368,748	US 2007/0145987	TEST PROBE FOR HIGH-FREQUENCY MEASUREMENT
D7600154DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2006 015 473.8	DE 10 2006 015 473 A1	Verfahren und Vorrichtung zur Erfassung submikroskopischer Strukturen
D7600160DE	GM	eingetragen	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	20 2006 010 086.5	20 2006 010 086.5	Adapter zur Positionierung von Kontaktspitzen
D7600302US	PT	erteilt	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	11/531,092	US-2007-0296402-A1	Adapter for positioning of contact tips
D7600304DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2006 038 457.1-35	DE 10 2006 038 457 A1	Verfahren und Vorrichtung zum Temperieren elektronischer Bauelemente
D7600329DE	GM-P	eingetragen	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	20 2004 021 128.9	20 2004 021 128.9	Vorrichtung zum Testen von Substraten
D7600367DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2006 054 673.3-35	DE 10 2006 054 673 A1	Sondenaufnahme zur Halterung einer Sonde zur Prüfung von Halbleiterbauelementen, Sondenhalterarm und Prüfvorrichtung
D7600379DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2007 005 208.3-33		Verfahren zum Prüfen elektronischer Bauelemente und Prüfvorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
D7600383DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2006 056 543.6-35	10 2006 056 543.6	Sondenhalter für eine Sonde zur Prüfung von Halbleiterbauelementen
D7600384DE	PT	erteilt	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2006 056 646.7-35	DE 10 2006 056 646 A1	Sondenhalter für eine Sonde zur Prüfung von Halbleiterbauelementen
D7600387US	PT	angemeldet	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	11/940,355	US-2008-0116918-A1	Probe station with EMI shielding for testing of semiconductor devices
D7600409US	PT	angemeldet	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	11/674,205	US-2008-0122465-A1	Probe holder for a probe for testing semiconductor components
D7600410US	PT	erteilt	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	11/674,430	US-2008-0122468-A1	Probe holder for a probe for testing semiconductor components

D7600430DE	PT	erteilt	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2007 006 066.3-51	DE 10 2007 006 066 A1	Vorrichtung zum schnellen Wechseln von Objektiven mit Gewindebefestigung
D7600432US	PT	erteilt	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	11/674,208	US-2008-0116911-A1	Probe receptacle for mounting a probe for testing semiconductor components, probe holder arm and test apparatus
D7700015DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2007 004 253.3-33		Verfahren und Vorrichtung zur Korrektur fehlerhafter Solder-Bump-Arrays
D7700023DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2007 063 299.3-56	DE 10 2007 063 299 A1	Anordnung und Verfahren zur Bilderfassung an einem Prober
D7700024DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2007 063 298.5-56	DE 10 2007 063 298 A1	Anordnung und Verfahren zur fokussierten Mehrebenen-Bilderfassung an einem Prober
D7700113DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2007 016 372.1-35	DE 10 2007 016 372 A1	Verfahren zur Messung der Impedanz elektronischer Schaltungen
D7700127US	PT	erteilt	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	11/765,019	US-2008-0315903-A1	Method for measurement of a device under test
D7700151US	PT	angemeldet	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	12/022,261	US-2009-0049944-A1	Micromanipulator for moving a probe
D7700170US	PT	erteilt	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	11/943,975	US-2008-0143365-A1	Probe station and method for measurements of semiconductor devices under defined atmosphere
D7700228US	PT	erteilt	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	11/839,899	US-2008-0042679-A1	Method and apparatus for controlling the temperature of electronic components
D7700296DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2007 041 608.S	DE 10 2007 041 608 A1	Prober zum Testen von Bauelementen
D7700342DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2007 053 862.8-33	DE 10 2007 053 862 A1	Prober zum Testen von Halbleitersubstraten mit EMI-Abschirmung
D7700356US	PT	angemeldet	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	11/964,747	US-2008-0158664-A1	ARRANGEMENT AND METHOD FOR IMAGE ACQUISITION ON A PROBER
D7700358DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2007 054 698.1-35	DE 10 2007 054 698 A1	Sondenhalterung und Verfahren zur Prüfung von Testsubstraten unter Verwendung der Sondenhalterung
D7700359US	PT	erteilt	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	11/940,354	US-2008-0116917-A1	Probe support and method for measurement of test devices using said probe support
D7700361US	PT	erteilt	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	11/947,206	US-2008-0180119-A1	Method for testing electronic components and test apparatus for carrying out the method
D7700364DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2008 021 242.3-56	DE 10 2008 021 242 A1	Vorrichtung und Verfahren zur Steuerung einer Bewegungseinrichtung
D7700365US	PT	angemeldet	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	12/111,222	US-2008-0284457-A1	Method and apparatus for control of a positioning device
D7700368US	PT	angemeldet	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	11/964,744	US-2008-0212078-A1	ARRANGEMENT AND METHOD FOR FOCUSING A MULTIPLANE IMAGE ACQUISITION ON A PROBER
D7700370DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2008 007 603.1-33	DE 10 2008 007 603 A1	Verfahren zur besseren Ausnutzung von Halbleitermaterial
D7700371US	PT	angemeldet	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	12/025,253	US-2010-0029022-A1	METHOD FOR IMPROVED UTILIZATION OF SEMICONDUCTOR MATERIAL
D7700372DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2008 013 978.5	DE 10 2008 013 978 A1	Chuck mit triaxialem Aufbau
D7700373DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2008 009 017.4-33	DE 10 2008 009 017 A1	Verfahren zur Messung eines Halbleitersubstrats
D7700374DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2007 054 879.8-35	DE 10 2007 054 879 A1	Verfahren und Anordnung zur Positionierung einer Probecard
D7700380DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2007 058 457.3-33	DE 10 2007 058 457 A1	Anordnung und Verfahren zur Testung von Halbleitersubstraten unter definierter Atmosphäre
D7700402DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2007 057 394.6-35	DE 10 2007 057 394 A1	Verfahren zum Kalibrieren eines vektoriiellen Netzwerkanalysators mit mehr als zwei Toren
D7700403DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2007 057 393.8-35	DE 10 2007 057 393 A1	Verfahren zum Kalibrieren eines Netzwerkanalysators mit definierter Anzahl von Messstellen
D7700416KR	PT-PCT	angemeldet	KR	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10-2010-7010266		METHOD FOR TESTING A TEST SUBSTRATE UNDER DEFINED THERMAL CONDITIONS AND THERMALLY CONDITIONABLE PROBER
D7700416US	PT-PCT	angemeldet	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	12/681,806		METHOD FOR TESTING A TEST SUBSTRATE UNDER DEFINED THERMAL CONDITIONS AND THERMALLY CONDITIONABLE PROBER

D7700416WO	PT-PCT	angemeldet	WO	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	PCT/EP2008/063154	WO 2009/050038	Verfahren zur Prüfung eines Testsubstrats unter definierten thermischen Bedingungen und thermisch konditionierbarer Prober PROBE HOLDER
D7700417KR	PT-PCT	angemeldet	KR	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10-2010-7010276		PROBE HOLDER
D7700417US	PT-PCT	angemeldet	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	12/681,967		PROBE HOLDER
D7700417WO	PT-PCT	angemeldet	WO	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	PCT/EP2008/063678	WO 2009/050127	Sondenhaltevorrichtung
D7800001DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2008 009 338.6-35	DE 10 2008 009 338 A1	Verfahren zur Messfehlerermittlung bei Streuparametermessungen
D7800002US	PT	angemeldet	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	12/030,295	US-2008-0195344-A1	Method for determining measurement errors in scattering parameter measurements
D7800020US	PT	angemeldet	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	12/018,506	US-2008-0173697-A1	Method and apparatus for the correction of defective solder bump arrays
D7800071US	PT	angemeldet	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	12/048,323	US-2008-0224426-A1	Chuck with triaxial construction
D7800294DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2008 029 380.6-35		Testeinrichtung zum Testen von Polymerelektronik
D7800334US	PT	angemeldet	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	12/199,401	US 2010/0011569 A1	Apparatus and method for assembling several semiconductor devices onto a target substrate
D7800359DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2008 038 184.5-35	DE 10 2008 038 184 A1	Verfahren und Vorrichtung zur temporären elektrischen Kontaktierung einer Solarzelle
D7800374DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2008 038 186.1-35	DE 10 2008 038 186 A1	Sonde zur temporären elektrischen Kontaktierung einer Solarzelle
D7800384DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2008 038 600.6-1S	DE 10 2008 038 600 A1	Mikromanipulator zur Bewegung einer Kontaktspitze
D7800408TW	PT	angemeldet	TW	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	097137S90	200921108	Verfahren und Anordnung zur Positionierung einer Probecard
D7800409KR	PT	angemeldet	KR	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	96512/2008		METHOD AND ARRANGEMENT FOR POSITIONING A PROBE CARD
D7800422DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2008 048 081.9-33	DE 10 2008 048 081 A1	Verfahren zur Prüfung elektronischer Bauelemente einer Wiederholstruktur unter definierten thermischen Bedingungen
D7800423DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2008 047 337.5-33	DE 10 2008 047 337 A1	Verfahren zur Prüfung eines Testsubstrats in einem Prober unter definierten thermischen Bedingungen
D7800519DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2009 005 182.1-33	DE 10 2009 005 182 A1	Chuck und Verfahren zur Aufnahme und Halterung dünner Testsubstrate
D7800541US	PT	angemeldet	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	12/345,980	US 2009/0179658 A1	Prober for testing devices in a repeat structure on a substrate
D7900044DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2009 008 320.0-52		Verfahren und Vorrichtung zur Messung von Impedanzen biologischer Proben
D7900134DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2009 030 471.1-35	DE 10 2 009 030 471 A1	Chuck zur Aufnahme und Halterung eines Testsubstrats und eines Kalibriersubstrats
D7900174US	PT	angemeldet	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	12/489,913	US-2009-0315581-A1	Chuck for supporting and retaining a test substrate and a calibration substrate
D7900175US	PT	angemeldet	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	12/488,702	US-2009-0314051-A1	Method for ascertainment of electrical properties of electronic components and method for calibration the measuring unit
D7900229DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2009 029 906.8-35	DE 10 2009 029 906 A1	Verfahren zur Ermittlung elektrischer Eigenschaften elektronischer Bauelemente und Verfahren zur Kalibrierung der Messeinheit
D7900231DE	PT	angemeldet	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	10 2009 030 043.0		Verfahren zur Messung eines Leistungsbaulements
D7900273US	PT	angemeldet	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	12/539,177	US 2010/0045264 A1	Probe for electrical contacting of solar cells
D7900274CN	PT	angemeldet	CN	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	20091016341 0.7	CN 101655511A	Sonde zur temporären elektrischen Kontaktierung einer Solarzelle
D7900275TW	PT	angemeldet	TW	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	098125516	201009349	Sonde zur temporären elektrischen Kontaktierung einer Solarzelle
D7900314WO	PT-PCT	angemeldet	WO	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	PCT/EP2009/059962	WO 2010/028914	Verfahren zur Prüfung eines Testsubstrats in einem Prober unter definierten thermischen Bedingungen

D7900317CN	PT	angemeldet	CN	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	20091016340 9.4	CN 101655539A	Verfahren und Vorrichtung zur temporären elektrischen Kontaktierung einer Solarzelle
D7900318TW	PT	angemeldet	TW	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	098127144	201009351	Verfahren und Vorrichtung zur temporären elektrischen Kontaktierung einer Solarzelle
D7900319US	PT	angemeldet	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	12/S41,530	US 2010/0045265 A1	Method and apparatus for electrical contacting of solar cells
D7900348WO	PT-PCT	angemeldet	WO	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	PCT/EP2009/061274	WO 2010/031685	Verfahren zur Prüfung elektronischer Bauelemente einer Wiederholstruktur unter definierten thermischen Bedingungen
D7900415US	PT	erteilt	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	12/329,968		Method and arrangement for positioning a probe card
D7900523WO	PT-PCT	angemeldet	WO	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	PCT/EP2009/067713	WO 2010/081617	Chuck und Verfahren zur Aufnahme und Halterung dünner Testsubstrate
D8000001US	PT	angemeldet	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH, Schneidewind, Dietrich, Klesewetter, Teich, Thäringen	12,619,327	US-2010-0111403	METHOD FOR INCREASING THE ACCURACY OF THE POSITIONING OF A FIRST OBJECT RELATIVE TO A SECOND OBJECT
D8000002US	PT	angemeldet	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	12/609,155	US 2010/0106439	Method for Measurement of Impedance of Electronic Circuits
D8000023DE	GM	eingetragen	DE	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	20 2010 002 527.3	20 2010 002 527.3	Messanordnung zur Messung elektronischer Bauelemente mit Kontaktanordnung und Kalibriersubstrat
D8000345US	PT	angemeldet	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	12/847,308		ARRANGEMENT AND METHOD FOR IMAGE ACQUISITION ON A PROBER
D8000346US	PT	angemeldet	US	SUSS MicroTec Test Systems GmbH	12/847,723		ARRANGEMENT AND METHOD FOR FOCUSING A MULTIPLANE IMAGE ACQUISITION ON A PROBER